

# Cestos De Limpeza De Wafer Em Ptfе Personalizados Suportes De Wafer De Silício Para Semicondutores Cassetes De Fluoropolímero De Baixo Background

Número do item: PL-CP266



## introdução

Cestos de limpeza de wafer em PTFE personalizados de alta pureza para processamento de semicondutores. Projetados para análise de traços com baixo background e resistência química agressiva, esses cassetes de fluoropolímero personalizados garantem dissolução zero e manuseio sem contaminação de wafers de silício em ambientes de sala limpa críticos e laboratórios industriais.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
<b>Limpeza RCA (SC-1/SC-2)</b>	Remoção de contaminantes orgânicos, camadas finas de óxido e impurezas iônicas de superfícies de silício.	Alta resistência a misturas de peróxido de hidrogênio e hidróxido de amônio.
<b>Corrosão com Ácido Fluorídrico</b>	Remoção seletiva de camadas de dióxido de silício e passivação superficial.	Imunidade completa ao HF, que degrada transportadores de quartzo ou vidro.
<b>Processamento de Corrosão Piranha</b>	Remoção agressiva de resíduos orgânicos pesados e fotorresiste usando ácido sulfúrico e peróxido.	Mantém a integridade estrutural em ambientes altamente exotérmicos e oxidantes.
<b>Suporte à Fotolitografia</b>	Manuseio de wafers durante o desenvolvimento, remoção e enxágue de materiais de fotorresiste.	A resistência a solventes garante que o transportador não inche ou amoleça quando exposto a removedores.
<b>Enxágue Pós-CMP</b>	Limpeza crítica de wafers após Planarização Mecânico-Química para remover pastas abrasivas.	A superfície com baixa geração de partículas garante que os wafers permaneçam limpos após a etapa de polimento.
<b>Preparação de Semicondutores Compostos</b>	Limpeza especializada de wafers de GaAs, GaN e InP para optoeletrônica avançada.	Suporte suave com ranhuras de precisão evita danos a materiais compostos frágeis.
<b>Limpeza Ultrasônica/Megassônica</b>	Limpeza por vibração de alta frequência para desalojar partículas submicrométricas em água deionizada.	As propriedades do material amortecem vibrações excessivas, permitindo transferência de energia eficaz.

Categoria de Parâmetro	Detalhe da Especificação para PL-CP266
<b>Material Principal</b>	PTFE (Politetrafluoretileno) / PFA (Perfluoroalcóxi) de Alta Pureza
<b>Método de Fabricação</b>	Usinagem CNC de Alta Precisão (Fabricado sob Medida)
<b>Compatibilidade com Tamanho de Wafer</b>	Totalmente Personalizável (Tamanhos comuns: 2", 3", 4", 6", 8", 12" ou dimensões personalizadas)
<b>Configuração de Ranhuras</b>	Espaçamento, profundidade e quantidade personalizados com base nos requisitos do processo
<b>Projeto da Alça</b>	Opções fixa, removível ou olhos de elevação integrados (Personalizável)
<b>Resistência Química</b>	Excelente (Compatível com todos os ácidos, bases e solventes orgânicos)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
<b>Categoria de Parâmetro</b>	<b>Detalhe da Especificação para PL-CP266</b>	
<b>Faixa de Temperatura de Operação</b>	-200°C a +260°C (Limite do material; específico da aplicação)	
<b>Rugosidade Superficial</b>	Acabamento CNC controlado para captura mínima de partículas	
<b>Background de Elementos Traço</b>	Otimizado para análise de traços de baixo nível (atende aos requisitos de baixo background)	
<b>Perfil de Dissolução</b>	Dissolução zero / Sem aditivos lixiviáveis (sem dissolução)	